公司代码：688729　　公司简称：屹唐股份

北京屹唐半导体科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"四、风险因素"部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.273元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为2,955,560,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,686,788.00元（含税）。上述事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	屹唐股份	688729	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单一	阎美芝
联系地址	北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号	北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号
电话	010-87842689	010-87842689
传真	010-67854899	010-67854899
电子信箱	ir@bestsemi.com	ir@bestsemi.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

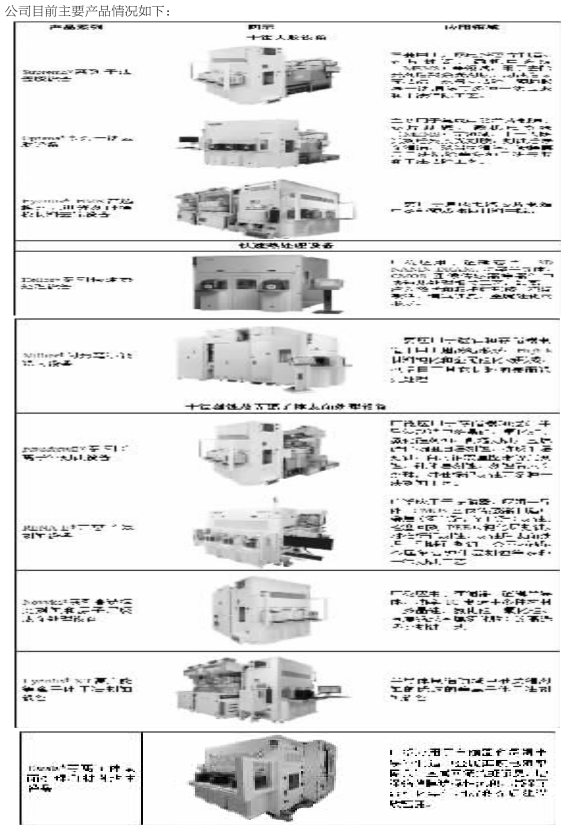
1、主要业务

公司主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，面向全球集成电路制造厂商提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀及等离子体表面处理设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。

公司依靠自主研发的核心技术，致力于为集成电路制造环节提供更先进处理能力和更高生产效率的集成电路设备。公司主要设备相关技术达到国际领先水平，干法去胶设备、快速热处理设备已应用在多家国内外知名集成电路制造商生产线上并实现大规模装机，干法刻蚀及等离子体表面处理设备已应用在多家国内外知名集成电路制造商生产线上，销售收入持续快速增长。

2、主要产品

公司目前主要产品情况如下：



报告期内，公司的主营业务未发生变化。

2.2主要经营模式

公司结合国家集成电路产业政策、市场发展和供需情况、半导体专用设备行业特点、公司主营业务、主要产品和自身发展阶段等因素，形成了目前的经营模式，经营模式与同行业惯例一致。具体如下：

1、盈利模式

公司主要从事集成电路设备的研发、生产和销售，通过向存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商、功率器件制造厂商等集成电路制造厂商和硅片制造厂商销售干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备，同时提供配件和服务来实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于集成电路设备产品的销售以及设备相关配件销售，提供设备升级维护服务等。

2、研发模式

公司依照行业国际惯例建立产品研发流程及相关制度，对研发项目的立项、审批、执行等流程进行了规定。公司的新产品研发及商业化流程可以大致分为可行性研究阶段、产品开发及下线阶段、客户端认证阶段、量产及生命周期维护阶段。

公司研发部门包含工程设计和工艺开发团队，分别负责干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备各个产品线包括机械设计、温控与仿真、电气设计、软件设计、工艺开发、新技术开发等各类开发内容。公司建立了科学、规范的研发工作制度，并以市场需求作为技术创新导向，按照多种核心技术、多种产品进行新技术、新工艺、新产品的研发。通过对公司所有研发项目进行立项评审以及验收评审，保证公司研发目标的实现。

3、采购模式

为应对全球半导体供应链波动与地缘政治风险，公司建立了系统、科学的供应链评估与管理体系。不仅覆盖资质、产能、技术、质量、价格、交期、服务等基础要素，更强化了对关键零部件国产化能力及供应链抗风险指标的量化评估。公司已与全球众多供应商建立了长期稳定的合作关系，确保合格供应商的长期稳定性。同时从需求预测、库存管理、供应商管理三方面进行动态协调，以确保供应稳定的前提下做到成本最优。中国制造基地近年积极推行供应链多元化与本地化战略，有效提高了设备零部件国产化率，缩短物流周期并降低采购成本，做到了供应链整体安全、可控。

4、生产模式

公司采用"客户订单驱动+战略库存驱动"的柔性生产模式，实现精准交付与快速响应的双重优势。客户订单驱动模式下，根据客户采购合同定制化生产，确保产品与需求高度匹配；战略库存驱动模式则针对通用型设备及组件进行前瞻性生产，有效缩短紧急订单交付周期，同时优化产能利用率。两种模式协同运作，既保障了订单交付质量，又提升了市场响应速度。通过对员工进行多技能培训，对生产场地进行升级改造，打造了柔性化生产线，从而具备快速调整不同产品产能的能力，以快速应对市场需求波动。

5、销售模式

公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。公司设备销售流程主要包括客户需求调研、技术交流、需求反馈与产品认证、销售洽谈与合同签订、发货、客户验收及售后服务等阶段。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、半导体设备市场规模高速增长

半导体产业作为现代信息技术产业的基石，是支撑数字经济、人工智能、新能源汽车等战略性新兴产业发展的核心基础，其技术水平和产业规模已成为衡量国家综合竞争力的关键指标。受益于人工智能相关应用的爆发式需求带动的高性能计算与数据中心基础设施的持续投资以及汽车电子、工业控制等新兴应用对半导体市场需求的多元化支撑，全球半导体市场规模高速增长，根据WSTS预测数据，2025年全球半导体市场规模预计将达到7,720亿美元，同比增长22.5%。展望2026年，全球半导体市场规模有望进一步增长至超过9,750亿美元，同比增长超过25%，首次逼近万亿美元大关。

半导体设备是集成电路制造的核心载体，其技术水平直接决定了芯片的制程能力、性能指标和生产良率。随着微观器件越做越小，结构越做越复杂，半导体设备的极端重要性更加凸显出来。半导体设备行业作为集成电路产业的基石，正处于市场规模增长与技术迭代加速的关键发展阶段。根据SEMI的统计数据，全球半导体设备市场（含前端晶圆制造及后端封测设备）在2025年达到创纪录的1,351亿美元，较2024年增长15.4%；SEMI预计2026年全球半导体设备市场规模将进一步扩大至1,450亿美元，同比增长7.3%。

2、半导体设备行业基本特点及主要技术门槛

半导体行业受国际经济波动、终端消费市场需求变化等方面影响，其发展往往呈现一定的周期性波动特征。在行业景气度较高时，半导体制造企业往往加大资本性支出，快速提升对半导体设备的需求；但在行业景气度下降过程中，半导体企业则可能削减资本支出，从而对半导体设备的需求产生不利影响。

半导体芯片应用领域极其广泛，既涵盖高性能计算、高端存储器等先进制程芯片需求，也包括电源管理、传感器、汽车电子、显示驱动、MCU、射频前端、功率器件、物联网芯片及工业控制等成熟制程芯片的庞大市场。尽管AI驱动下先进制程芯片需求呈爆发式增长，但并未挤压成熟制程芯片的生存空间，两者呈现并行发展态势。据集邦咨询（TrendForce）统计，2023年中国大陆28nm及以上成熟制程半导体制造产能占全球产能份额约29%，到2027年将进一步提升至33%，成为全球成熟制程半导体制造产能的主要贡献者。

半导体设备价值较高、技术复杂，半导体芯片制造商对于半导体设备的生产效率、良率提升、产品稳定性等方面具有很高的要求，对半导体供应商新设备的验证周期长、替代成本高，因此，半导体设备企业在客户验证、开拓市场方面周期较长，难度较大，产品成功导入客户量产线后客户稳定性也较高。

半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，半导体设备的研发涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、通讯、软件系统等众多学科领域，具有较高的技术研发门槛。在硬件、软件的支撑之外，半导体设备在客户端不同工艺制程产线上大量应用的过程中，设备厂商长久积累的实际应用经验（know-how）对于其进行产品改进和升级换代以及进一步的技术研发也非常重要，这种隐形的影响因素也进一步提升了半导体设备的研发门槛。随着高端逻辑芯片向2纳米及更先进制程迈进、先进存储器芯片向3D结构持续演进、先进封装技术等芯片技术的快速迭代，半导体设备面临着更高的技术挑战与技术创新需求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在半导体设备领域，应用材料、泛林半导体、东京电子等国际龙头成立时间长，产品线布局相对完善，并在巩固自身优势基础上积极进行技术升级，占据了绝大部分市场份额。近年来，在中国大陆半导体制造投资浪潮推动下，国内半导体设备行业进入快速发展阶段。

1、干法去胶设备

在先进芯片制造工艺中，对底层材料的保护要求已达到原子级。干法去胶设备技术要求不断提高，干法去胶工艺逐渐成为先进光刻系列工艺中的一道关键步骤，设备应用也不断扩大。

公司的干法去胶设备在全球范围内的集成电路制造产线中具有广泛应用，设备工艺效果优异，具备颗粒污染低、连续生产时间长、大规模量产综合持有成本低等卓越性能，可满足各类制程工艺需求，尤其是在先进逻辑、先进存储及特色工艺芯片制造领域更具有竞争优势。

全球干法去胶设备领域的主要参与者包括PSK（比思科）、屹唐股份、ULVAC（爱发科）等。根据Gartner统计数据，2025年，干法去胶设备领域前五大厂商的市场份额合计超过90%，公司凭借33.7%的市场占有率位居全球第二，确立了在干法去胶设备细分市场中国际领先的行业地位，公司的去胶设备在国内市场亦占据领先地位。公司开发推出了新一代先进干法去胶设备Optima?，并持续开发新产品，进一步巩固公司在干法去胶设备领域的领先优势。

2、快速热处理设备

近年来，先进尖峰退火、激光/闪光毫秒退火在内的快速热处理技术越来越受到集成电路制造厂商的关注。随着集成电路性能不断提高的要求，快速热退火技术在晶圆加工/集成电路制造中的竞争优势越来越明显：相比普通炉管退火设备几小时的加热时长，快速热退火设备只需几秒甚至几毫秒便可使晶圆上升至所需温度，总体热预算较低，可以更好地提高晶圆的性能，满足先进集成电路制造的需求。

公司的常压快速热处理设备采用晶圆双面辐射加热技术，具有温度均匀性好、有效减少晶圆热应力和图形效应、加热速度快、产出高等优势；毫秒级退火设备采用受专利保护的水壁氩气弧灯技术，具有优异的晶圆温度控制能力，独特的脉冲持续时间调整功能和一体式尖峰退火、闪光毫秒级退火功能相结合，提供了广泛的工艺应用。公司的常压快速热处理相关产品覆盖了国内外知名存储芯片、逻辑芯片、功率半导体、硅片制造厂商等领域广泛的客户。

应用材料在全球快速热处理设备领域占据绝对领先地位，根据Gartner统计数据，2025年，应用材料占有的全球快速热处理市场份额达到57.0%，公司占有的全球快速热处理市场份额为13.8%，在闪光退火设备领域市场份额位居全球第二。全球快速热处理市场的其他主要参与者包括维易科、科意半导体等。报告期内，公司借助在高温快速热处理、等离子体源及超高产出设备平台等领域的技术积累，持续开展多项新型快速热处理设备研发工作，尤其是加速推进低压快速热处理相关设备的研发，进一步扩大可服务市场规模。

3、干法刻蚀及等离子体表面处理设备

干法刻蚀设备是半导体制造中价值量最高的核心设备之一，技术壁垒极高，随着先进制程向2nm及以下演进及3D NAND堆叠层数持续增加，刻蚀工序数量大幅增加，对刻蚀设备的精度、选择比及产能效率提出了更高要求；先进制程和3D结构芯片制造中材料表面质量直接影响器件性能，等离子体表面处理设备通过远程等离子体源产生高浓度的自由基用于先进逻辑芯片、DRAM动态随机存取存储器、3D NAND闪存等工艺的选择性材料处理及改性等原子层级表面处理，应用场景持续扩大。

公司的刻蚀设备采用电感耦合等离子体（Inductively Coupled Plasma，简称ICP）技术实现离子能量与密度的独立控制，具备刻蚀速度快、产能高、使用成本低、等离子体损伤低等优势；高选择比刻蚀设备（可刻蚀多晶硅、钨、氮化钛等材料，根据应用气体和刻蚀材料的不同，选择比最高可达上百比一）、等离子体表面处理设备基于业界领先的远程等离子体与离子辅助控制技术，可满足先进芯片制造中多道尖端刻蚀和原子层级晶圆表面处理要求。公司的干法刻蚀设备和等离子体表面处理相关设备已应用于国内外知名存储芯片和逻辑芯片制造企业客户，销售收入持续快速增长。

全球干法刻蚀设备市场主要由国际巨头主导，根据Gartner统计数据，2025年，前三大厂商泛林半导体、东京电子及应用材料合计占有全球干法刻蚀设备领域82.2%的市场份额，市场格局高度集中。公司是国内为数不多可以量产干法刻蚀设备的厂商，根据Gartner统计数据，2025年公司以0.5%的市场占有率位居全球第九。报告期内，公司推出了新一代先进干法刻蚀设备RENA-E?、先进等离子体表面处理和材料改性设备Escala?，并持续开展多项新型干法刻蚀及等离子体表面处理设备研发工作，进一步扩大可服务市场规模。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，全球半导体制造产业在人工智能、高性能计算等新兴应用驱动下持续向先进制程演进，对半导体设备的需求量和性能要求同步提升。

1、先进制程、三维结构和先进封装推动设备需求增长

随着芯片制程不断微缩、存储芯片三维堆叠层数持续增加以及先进封装技术的持续演进，半导体制造工序日趋复杂，对设备的需求量显著增长。例如，在存储芯片领域，报告期内，主流3D NAND产品堆叠层数已迈向200层以上，并向300层乃至更高层数演进，层数增加直接导致刻蚀、去胶工序数量大幅增长；高带宽存储器（HBM）通过硅通孔（TSV）技术实现多颗DRAM芯片的垂直堆叠，对深硅刻蚀设备的需求持续增长；先进逻辑制程对掺杂激活、高k金属栅堆叠、沟道损伤修复的热处理工艺提出原子级精度要求，成为快速热处理设备需求增长的驱动力。

2、先进制程、三维结构和先进封装对设备性能提出更高要求

当前先进制程逻辑芯片制造持续向2纳米及以下节点演进，芯片线宽尺寸缩小至原子级，芯片制造精度要求达到前所未有的严苛程度。同时，3D堆叠技术通过垂直堆叠多层晶体管提升集成度，这一过程大幅增加了制造工艺复杂性。在先进逻辑芯片制造领域，晶体管结构正从FinFET向GAA（全环绕栅极）架构过渡，GAA晶体管需通过选择性刻蚀精确去除牺牲层以释放纳米线沟道，要求刻蚀精度达到原子级别。原子层刻蚀（ALE）技术通过"表面改性——选择性去除"的循环机制，可实现单原子层的可控刻蚀，成为GAA架构芯片制造的关键技术。

先进制程芯片制造对快速热处理设备的热预算控制精度、温度均匀性、热应力管理能力、工艺兼容性等要求愈发严苛。高端快速热处理设备能有效抑制杂质扩散、实现更浅的结深，确保高效退火与掺杂激活，同时严格控制热预算，减少热循环中的应力积累，成为支撑先进逻辑与存储芯片制造的关键工艺设备。

先进制程芯片制造对干法去胶设备的技术水平也提出了更高的要求，先进干法去胶设备需要满足低温工艺和高深宽比结构适应性，原子级清洁度，高选择性去胶的同时不损坏底层材料及器件结构，大规模量产中实现高产能以及低持有成本等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	11,383,768,568.78	9,952,915,308.70	14.38	8,341,075,857.53
归属于上市公司股东的净资产	8,916,417,247.80	5,914,723,200.11	50.75	5,343,142,503.68
营业收入	5,076,317,948.58	4,632,977,839.11	9.57	3,931,426,986.51
利润总额	680,426,938.91	512,350,239.97	32.81	264,822,861.19
归属于上市公司股东的净利润	670,779,306.87	540,802,071.81	24.03	309,419,319.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,706,877.18	484,465,205.09	11.61	270,108,346.25
经营活动产生的现金流量净额	-294,917,595.40	682,274,724.36	-143.23	599,573,630.02
加权平均净资产收益率（%）	9.05	9.61	减少0.56个百分点	6.00
基本每股收益（元／股）	0.24	0.20	20.00	0.12
稀释每股收益（元／股）	0.24	0.20	20.00	0.12
研发投入占营业收入的比例（%）	14.55	15.47	减少0.92个百分点	15.47

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,159,925,765.82	1,322,053,247.83	1,314,364,013.28	1,279,974,921.65
归属于上市公司股东的净利润	217,565,687.50	130,230,689.16	167,832,879.99	155,150,050.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	139,925,684.88	114,509,782.40	158,242,077.22	128,029,332.68
经营活动产生的现金流量净额	-231,438,984.13	-289,008,558.42	-3,301,600.40	228,831,547.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,897
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,608
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙）	0	1,198,456,133	40.55	1,198,456,133	无		其他
BEST Holdings #1, LLC	0	262,461,892	8.88	262,461,892	无		境外法人
Oceanpine Marvelous Limited	0	191,752,980	6.49	191,752,980	无		境外法人
天津环旭创芯管理咨询有限公司	0	132,329,530	4.48	132,329,530	无		境内非国有法人
江苏招银产业基金管理有限公司－南京招银现代产业壹号股权投资基金（有限合伙）	0	101,141,707	3.42	101,141,707	无		其他
海南鸿道股权投资基金管理有限公司－宁波梅山保税港区鸿道致鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	0	83,226,120	2.82	83,226,120	无		其他
共青城渐升创业投资合伙企业（有限合伙）	0	70,176,263	2.37	70,176,263	无		其他
天津宸辉私募基金管理有限公司－天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	0	66,580,895	2.25	66,580,895	无		其他
红杉鹏辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	0	53,264,716	1.80	53,264,716	无		其他
BEST Holdings #2, LLC	0	52,132,842	1.76	52,132,842	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	环旭创芯的实际控制人陈立庚和海松非凡的实际控制人陈立光为兄弟关系。BH1、BH2为公司员工持股平台。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

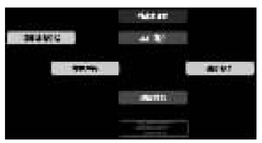
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体参见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"二、经营情况讨论与分析"之"（一）报告期内主要经营情况"。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688729　　证券简称：屹唐股份　　公告编号：2026-006

北京屹唐半导体科技股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规及相关制度的规定，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司董事。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）独立董事薪酬方案

公司独立董事2026年度津贴标准为15万元（税前）/年，按季度发放。

（二）非独立董事薪酬方案

在公司担任其他职务的董事和职工代表董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事职务薪酬。

未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688729　　证券简称：屹唐股份　　公告编号：2026-007

北京屹唐半导体科技股份有限公司关于公司职工代表董事离任暨补选职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到职工代表董事黄葵红女士提交的书面辞职报告，黄葵红女士因即将退休，申请辞去公司第二届董事会职工代表董事职务。
- 公司于2026年4月28日召开职工代表大会，选举王志远先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

一、职工代表董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄葵红	职工代表董事	2026年4月28日	2026年12月22日	即将退休	是，将继续在公司任职直至退休手续办理完毕	企业发展副总裁	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，黄葵红女士的辞任不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，黄葵红女士不存在应当履行而未履行的公开承诺，并已按照公司相关规定做好辞任交接工作。

二、新任职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月28日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举王志远先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，王志远先生的简历详见附件。

王志远先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：第二届董事会职工代表董事简历

王志远，男，1984年出生，硕士研究生学历。2008年7月至2015年3月任北京京城环保股份有限公司投资项目经理；2015年3月至2026年4月历任北京亦庄国际投资发展有限公司投资经理、部门总经理助理；2020年10月至今，任江苏影速集成电路装备股份有限公司董事。2026年4月加入公司，任总务助理副总裁，负责公司总务、内部审计等工作。

截至本公告披露日，王志远先生未直接持有公司股份。王志远先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。王志远先生不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（下转B000版）

证券代码：688729　　证券简称：屹唐股份

北京屹唐半导体科技股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,037,189,378.79	1,159,925,765.82	-10.58
利润总额	159,405,279.94	182,813,290.35	-12.80
归属于上市公司股东的净利润	159,346,898.78	217,565,687.50	-26.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,452,052.99	139,925,684.88	-24.64
经营活动产生的现金流量净额	197,011,529.88	-231,438,984.13	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50
加权平均净资产收益率（%）	1.78	3.61	减少1.83个百分点
研发投入合计	183,374,141.50	178,958,397.25	2.47
研发投入占营业收入的比例（%）	17.68	15.43	增加2.25个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,893,301,823.29	11,383,768,568.78	-4.31
归属于上市公司股东的所有者权益	9,022,140,484.05	8,916,417,247.80	1.19

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,733,486.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	47,648,271.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,215.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-495,127.22	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	53,894,845.79	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系上年同期为业务的可持续增长提前储备关键存货导致经营活动产生的现金流量为净流出。
基本每股收益（元/股）	-37.50	主要系报告期归属于上市公司股东的净利润下降以及公司于 2025 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 295,560,000 股导致报告期股份数量相比于上年同期增加所致。
稀释每股收益（元/股）	-37.50	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙）	其他	1,198,456,133	40.55	1,198,456,133	1,198,456,133	无	/
BEST Holdings #1, LLC	境外法人	262,461,892	8.88	262,461,892	262,461,892	无	/
Oceanpine Marvelous Limited	境外法人	191,752,980	6.49	191,752,980	191,752,980	无	/
天津环旭创芯管理咨询有限公司	境内非国有法人	132,329,530	4.48	132,329,530	132,329,530	无	/
江苏招银产业基金管理有限公司－南京招银现代产业壹号股权投资基金（有限合伙）	其他	101,141,707	3.42	101,141,707	101,141,707	无	/
海南鸿道股权投资基金管理有限公司－宁波梅山保税港区鸿道致鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	83,226,120	2.82	83,226,120	83,226,120	无	/
共青城渐升创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	70,176,263	2.37	70,176,263	70,176,263	无	/
天津宸辉私募基金管理有限公司－天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	66,580,895	2.25	66,580,895	66,580,895	无	/
红杉鹏辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	53,264,716	1.80	53,264,716	53,264,716	无	/
BEST Holdings #2, LLC	境外法人	52,132,842	1.76	52,132,842	52,132,842	无	/

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	4,339,125	人民币普通股	4,339,125
胡海峰	1,621,912	人民币普通股	1,621,912
高建	1,227,690	人民币普通股	1,227,690
邓秀葵	1,126,115	人民币普通股	1,126,115
周小进	765,000	人民币普通股	765,000
廖木标	739,266	人民币普通股	739,266
吴太平	725,250	人民币普通股	725,250
朱绍陵	702,899	人民币普通股	702,899
刘林	690,914	人民币普通股	690,914
江苏弘伟投资发展有限公司	659,178	人民币普通股	659,178
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津环旭创芯管理咨询有限公司的实际控制人陈立庚和Oceanpine Marvelous Limited的实际控制人陈立光为兄弟关系。BEST Holdings#1,LLC、BEST Holdings#2,LLC为公司员工持股平台。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东胡海峰投资者信用证券账户持有数量1,617,044股。股东邓秀葵投资者信用证券账户持有数量1,058,142股。股东吴太平投资者信用证券账户持有数量725,250股。股东朱绍陵投资者信用证券账户持有数量136,720股。股东刘林投资者信用证券账户持有数量690,914股。股东江苏弘伟投资发展有限公司投资者信用证券账户持有数量659,178股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：北京屹唐半导体科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,398,485,340.05	2,261,872,827.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,870,844,541.10	1,329,859,007.09
衍生金融资产		
应收票据	8,162.89	-
应收账款	548,136,465.46	488,108,336.29
应收款项融资		
预付款项	60,757,426.73	60,997,289.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,733,951.97	13,894,926.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,287,071,429.04	3,435,573,317.49
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	305,768,499.57	480,267,386.70
流动资产合计	7,495,805,816.81	8,070,573,090.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,389,525.02	5,494,562.05
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	73,022,089.52	-
投资性房地产		
固定资产	963,001,704.59	943,798,437.31
在建工程	169,359,689.88	185,020,402.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	152,291,863.19	152,282,532.65
无形资产	66,755,778.31	70,525,604.28
其中：数据资源		
开发支出	26,460,242.67	-
其中：数据资源		
商誉	949,721,564.40	964,737,250.61
长期待摊费用	48,760,989.61	53,558,409.67
递延所得税资产	493,546,623.73	491,200,867.81
其他非流动资产	449,185,935.56	446,577,411.60
非流动资产合计	3,397,496,006.48	3,313,195,478.18
资产总计	10,893,301,823.29	11,383,768,568.78
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	316,816,970.16	353,879,678.76
预收款项		
合同负债	648,883,309.08	695,781,714.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,588,707.46	114,923,122.65
应交税费	54,061,942.73	59,144,910.80
其他应付款	46,758,775.73	87,302,168.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,985,904.30	409,179,125.59
其他流动负债	35,010,586.97	38,691,590.89
流动负债合计	1,213,106,196.43	1,758,902,312.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	349,840,000.00	395,499,043.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	177,498,327.55	175,416,483.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬	-	1,153,120.68
预计负债	18,346,968.47	17,780,139.06
递延收益	100,852,464.03	107,585,950.38
递延所得税负债	11,517,382.76	11,014,270.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	658,055,142.81	708,449,008.62
负债合计	1,871,161,339.24	2,467,351,320.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,955,560,000.00	2,955,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,714,586,474.89	3,713,167,832.45
减：库存股		
其他综合收益	131,049,740.04	186,092,045.01
专项储备		
盈余公积	191,063,884.30	191,063,884.30
一般风险准备		
未分配利润	2,029,880,384.82	1,870,533,486.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,022,140,484.05	8,916,417,247.80
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,022,140,484.05	8,916,417,247.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,893,301,823.29	11,383,768,568.78

公司负责人：张文冬　　主管会计工作负责人：谢姝　　会计机构负责人：顾琦

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：北京屹唐半导体科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,037,189,378.79	1,159,925,765.82
其中：营业收入	1,037,189,378.79	1,159,925,765.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	934,931,668.45	1,065,512,179.02
其中：营业成本	622,068,522.95	746,582,154.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,899,093.51	1,552,861.72
销售费用	85,642,346.37	75,059,495.31
管理费用	56,552,489.69	60,916,178.55
研发费用	156,913,898.83	178,958,397.25
财务费用	11,855,317.10	2,443,091.93
其中：利息费用	5,313,383.46	11,884,383.21
利息收入	7,388,566.33	11,735,338.77
加：其他收益	21,772,503.08	75,818,250.79
投资收益（损失以"-"号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	47,648,271.36	5,774,155.20
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-3,409,316.18	518,002.09
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-8,872,103.96	6,194,481.13
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-	-1,328.80
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	159,397,064.64	182,717,147.21
加：营业外收入	495,236.73	101,518.49
减：营业外支出	487,021.43	5,375.35
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	159,405,279.94	182,813,290.35
减：所得税费用	58,381.16	-34,752,397.15
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	159,346,898.78	217,565,687.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	159,346,898.78	217,565,687.50
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	159,346,898.78	217,565,687.50
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-55,042,304.97	5,171,024.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,042,304.97	5,171,024.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-55,042,304.97	5,171,024.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-55,042,304.97	5,171,024.00
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	104,304,593.81	222,736,711.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	104,304,593.81	222,736,711.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08

公司负责人：张文冬　　主管会计工作负责人：谢姝　　会计机构负责人：顾琦

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：北京屹唐半导体科技股份有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	947,167,878.72	1,211,486,216.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	275,399,688.00	41,504,201.96
收到其他与经营活动有关的现金	8,127,607.84	11,051,319.59
经营活动现金流入小计	1,230,695,174.56	1,264,041,737.68
购买商品、接受劳务支付的现金	569,259,066.90	1,034,928,240.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	314,444,121.77	341,791,999.45
支付的各项税费	111,406,404.33	103,855,352.91
支付其他与经营活动有关的现金	38,574,051.68	14,905,129.14
经营活动现金流出小计	1,033,683,644.68	1,495,480,721.81
经营活动产生的现金流量净额	197,011,529.88	-231,438,984.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,061,396.22	5,774,155.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	19,923.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,105,177,775.73	2,290,875,857.70
投资活动现金流入小计	1,109,239,171.95	2,296,669,936.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,978,258.94	73,449,271.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,677,368,345.81	2,103,188,214.19
投资活动现金流出小计	1,758,346,604.75	2,176,637,485.43
投资活动产生的现金流量净额	-649,107,432.80	120,032,450.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	434,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	11,125,024.24
筹资活动现金流入小计	-	445,125,024.24
偿还债务支付的现金	403,159,044.00	202,016,345.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,695,291.32	11,641,857.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,796,893.76	372,635,112.74
筹资活动现金流出小计	412,651,229.08	586,293,315.99
筹资活动产生的现金流量净额	-412,651,229.08	-141,168,291.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,586,352.44	-142,791.75
五、现金及现金等价物净增加额	-879,333,484.44	-252,717,616.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,240,408,034.46	2,705,914,532.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,361,074,550.02	2,453,196,915.75

公司负责人：张文冬　　主管会计工作负责人：谢姝　　会计机构负责人：顾琦

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月27日